

## Title (en)

Applicator device and method of filling concealed cavities with adhesives or sealants

## Title (de)

Applikationsgerät und Verfahren zum Verfüllen von Verdeckten Füllspalten mit Kleb- oder Dichtstoffen

## Title (fr)

Dispositif d'application et procédé pour le remplissage de cavités cachées avec agents adhésifs ou d' étanchéification

## Publication

**EP 1529902 A1 20050511 (DE)**

## Application

**EP 03025510 A 20031106**

## Priority

EP 03025510 A 20031106

## Abstract (en)

Application device comprises a feed line (2) partially arranged in a feed gap (3) and having an opening (4) in the direction of a filling gap (1) and a unit (5) for temporarily sealing the filling gap. The surfaces of the feed line and the filling gap lie at an angle alpha to each other. An independent claim is also included for a process for filling covered filling gaps with adhesive or sealing materials. Preferred Features: The angle alpha is an absolute value of 45-135, preferably 90 degrees. The maximum height of the opening corresponds to the gap width of the filling gap in the contact region between the feed line and the filling gap. Glass is used as one of the materials for delimiting the filling gap.

## Abstract (de)

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Applikationsgerät und ein Verfahren für das Verfüllen von verdeckten Füllspalten mit Kleb- oder Dichtstoffen. Dieses Applikationsgerät umfasst eine Zuführungsleitung (2), welche teilweise in einem Zuführungsspalt (3) angeordnet ist. Weiterhin weist diese Zuführungsleitung eine Öffnung (4), welche im Wesentlichen in Richtung Füllspalt (1) sowie Mittel (5) zum zumindest temporären Abdichten des Füllspaltes auf. Die Ebenen der Zuführungsleitung und diejenige des Füllspaltes stehen hierbei in einem Winkel  $\alpha$  zueinander. Weiterhin umfasst die Erfindung ein Verfahren zum Verfüllen von verdeckten Füllspalten sowie die mit einem solchen Verfahren abgedichteten oder verklebten Artikel.  
<IMAGE>

## IPC 1-7

**E04F 21/30**; B05C 17/005; B05C 7/00

## IPC 8 full level

**B05C 7/00** (2006.01); **B05C 17/005** (2006.01); **B05C 21/00** (2006.01); **E04F 21/30** (2006.01); **E06B 3/56** (2006.01)

## CPC (source: EP)

**B05C 17/00516** (2013.01); **B05C 21/00** (2013.01); **E06B 3/56** (2013.01)

## Citation (applicant)

WO 02070620 A1 20020912 - SIKA AG [CH], et al

## Citation (search report)

- [XA] US 4570834 A 19860218 - WARD DAVID J [GB]
- [A] GB 2352989 A 20010214 - INBIS LTD [GB]
- [X] FR 2745028 A1 19970822 - DAETWYLER FRANCE [FR]
- [X] DE 20307227 U1 20030814 - REHAU AG & CO [DE]

## Cited by

EP2564941A1; CN103764299A; US8622018B2; US8057845B2; WO2013030272A1; US8336483B2

## Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR

## DOCDB simple family (publication)

**EP 1529902 A1 20050511**; EP 1697602 A2 20060906; WO 2005045157 A2 20050519; WO 2005045157 A3 20050728

## DOCDB simple family (application)

**EP 03025510 A 20031106**; EP 04817559 A 20041105; EP 2004052834 W 20041105